

2020-2025年中国半导体封装用引线框架市场前景 预测及未来发展趋势报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2020-2025年中国半导体封装用引线框架市场前景预测及未来发展趋势报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/detail/485614.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 引线框架产品概述

1.1 引线框架概述

1.1.1 定义

1.1.2 引线框架在半导体封装中的应用

1.1.3 引线框架产品形态

1.1.4 引线框架产品特性与各功能结构

1.2 引线框架的发展历程

1.2.1 引线框架随着半导体封装技术发展而得到发展

1.2.2 当今及未来引线框架技术发展路线图

1.2.3 引线框架主流铜带材料的转变

1.3 引线框架在半导体产业发展中的重要地位

1.3.1 引线框架是适合半导体键合内引线连接的关键结构材料

1.3.2 引线框架在半导体封装中所担负的重要功效

1.3.3 引线框架在半导体封装的性能提高、成本控制上发挥着重要作用

第二章 引线框架产品品种、分类及性能要求

2.1 引线框架主流产品品种的演变

2.2 引线框架的品种分类

2.2.1 按照材料组成成分分类

2.2.2 按照生产工艺方式分类

2.2.3 按材料性能分类

2.2.4 按照使用的不同器件类别分类

2.3 引线框架材料的性能要求

2.3.1 对引线框架材料的性能要求

2.3.2 封装工艺对引线框架的性能要求

2.4 引线框架的国内外相关标准

2.4.1 国内相关标准

2.4.2 国外相关标准

第三章 引线框架的生产制造技术现况

3.1 引线框架成形加工两类工艺方式

3.2 冲制法生产引线框架

3.2.1 冲制法生产引线框架的工艺特点

3.2.2 冲制法的关键技术

3.3 蚀刻法生产引线框架

3.3.1 蚀刻法生产引线框架的工艺原理及过程

3.3.2 与冲制法相比的优点

3.4 引线框架表面电镀处理

3.4.1 引线框架表面电镀层的作用与特点

3.4.2 引线框架电镀的工艺流程及工艺条件

3.4.3 引线框架表面电镀加工生产线的类别

3.4.4 引线框架表面电镀加工工艺的发展

3.4.5 局部点镀技术

3.4.6 SN系无铅可焊性镀层

3.4.7 PPF引线框架技术

3.4.8 国内厂家开发高性能引线框架的电镀技术创新例

第四章 世界引线框架市场需求现状与分析

4.1 世界引线框架市场规模

4.2 世界引线框架产品结构的变化

4.3 世界引线框架市场格局

4.4 世界引线框架市场发展及预测

4.4.1 世界半导体产业发展现况

4.4.2 世界封测产业及市场现况

4.4.3 世界引线框市场发展前景

第五章 世界引线框架生产现况

5.1 世界引线框架生产总况

5.2 世界引线框架主要生产企业的市场份额情况

5.3 世界引线框架主要生产企业的情况

5.3.1 住友金属矿山公司

- 5.3.2 日本三井高科技股份公司
- 5.3.3 中国台湾顺德工业股份公司
- 5.3.4 日本新光电气工业公司
- 5.3.5 日本日立高新技术有限公司
- 5.3.6 大日本印刷公司
- 5.3.7 DIC
- 5.3.8 韩国丰山集团
- 5.3.9 宁波康强电子股份有限公司
- 5.3.10 先进半导体物料科技有限公司

第六章 我国国内引线框架市场需求现状

- 6.1 我国国内引线框架市场需求总述
 - 6.1.1 国内引线框架市场规模
 - 6.1.2 国内引线框架市场总体发展趋势
 - 6.1.3 国内引线框架市场的品种结构
- 6.2 国内引线框架的集成电路封装市场情况及发展
 - 6.2.1 我国集成电路产业发展现况与展望
 - 6.2.2 国内引线框架重要市场之一——集成电路封装产业现况及发展
- 6.3 国内引线框架的分立器件市场情况及发展
 - 6.3.1 国内分立器件产销情况
 - 6.3.2 国内分立器件的市场情况
 - 6.3.3 国内分立器件封装行业现况
- 6.4 国内引线框架的LED封装市场情况及发展
 - 6.4.1 引线框架的LED封装上的应用
 - 6.4.2 国内LED封装用引线框架行业情况
 - 6.4.3 国内LED封装产业发展现况与展望

第七章 我国国内引线框架行业及主要企业现况

- 7.1 国内引线框架产销情况
- 7.2 国内引线框架生产企业总况
- 7.3 近几年在国内引线框架企业的投建或扩产情况
- 7.4 当前国内引线框架行业发展的特点与存在问题
- 7.5 国内引线框架主要生产企业情况
 - 7.5.1 深圳先进微电子科技有限公司
 - 7.5.2 泰州友润电子科技股份有限公司

- 7.5.5 宁波康强电子股份有限公司
- 7.5.4 铜陵丰山三佳微电子有限公司
- 7.5.5 三井高科技（上海）有限公司
- 7.5.6 中山复盛机电有限公司
- 7.5.7 厦门永红科技有限公司
- 7.5.8 无锡华晶利达电子有限公司
- 7.5.9 广州丰江微电子有限公司
- 7.5.10 济南晶恒山田电子精密科技有限公司

第八章 引线框架材料市场及其生产现况

- 8.1 国内外引线框架制造业对铜带材料的性能需求
 - 8.1.1 (HJ 327) 对引线框架材料的主要性能要求
 - 8.1.2 引线框架材料市场在品种需求上的四个阶段的发展变化
- 8.2 引线框架材料的品种、规格及基本特性
 - 8.2.1 引线框架材料的品种
 - 8.2.2 引线框架制造中常用的铜合金材料品种
- 8.3 引线框架业对铜合金材料品种需求市场的情况
- 8.4 引线框架业对铜合金材料需求量的情况

第九章 国内外引线框架用铜合金带材生产技术的发展及主要生产厂家的

- 9.1 高性能引线框架铜合金材料生产技术
 - 9.1.1 铜合金的熔铸技术
 - 9.1.2 铜带的加工技术
- 9.2 高性能引线框架铜合金材料生产工艺与设备条件
 - 9.2.1 工艺技术方面
 - 9.2.2 设备条件
 - 9.2.3 国外工业发达国家工艺技术与装备情况
 - 9.2.4 C19400的工艺过程与技术环节要点
 - 9.2.5 获得高强度高导电铜合金的工艺途径
- 9.3 国外引线框架用铜带的主要生产厂商情况
- 9.4 国内引线框架用铜带的主要生产厂商情况
 - 9.4.1 我国铜及铜合金板带材的生产与需求情况
 - 9.4.2 我国引线框架用铜合金带材技术开发的情况
 - 9.4.3 我国引线框架用铜合金带材生产总况
 - 9.4.4 我国引线框架用铜合金带材主要生产厂情况

第十章 关于金属层状复合材料在引线框架领域应用前景的调查与分析

10.1 金属层状复合带材及其在国内的研发情况（AK LT）

10.2 金属层状复合材料的引线框架领域应用前景的调查与分析

10.2.1 金属层状复合材料在引线框架领域应用的可行性

10.2.2 对国外同类产品及其应用的调查

10.2.3 对金属层状复合材料的引线框架领域应用前景调查

10.2.4 对金属层状复合材料的引线框架领域市场情况的分析

详细请访问：<https://www.huaon.com/detail/485614.html>